

層數 : 2
材料 : FR4
板厚 : 1.57mm +/- 10 %
銅厚 : 1oz
表面 : ENIG (Au : 2-5u ")
阻焊 (銅) : 藍, LPI (銅)
阻焊 (銅) : 藍, 白

其他

規格 : 符合 IPC-6012 符合 IMMING GOLD PLATED
阻焊 .050uM 3-6uM NICKEL

板厚公差 .025 AVG, .020 MIN .. 銅厚公差 .500 銅厚公差 銅厚公差 銅厚公差 銅厚公差 銅厚公差.

其他 :

=====

*.GM4 : 銅厚

*.TXT : NC 銅厚

*.GTP : 銅厚

*.GTO : 銅厚

*.GTS : 銅厚

*.GTL : 銅厚

*.GBL : 銅厚

*.GBS : Bottom Soldermask

*.GBO : 銅厚

*.GBP : 銅厚



